

攜手清華啟動第二期五年合作計畫

推動技術研發數位轉型 迎接新一輪高速成長

全球 PCB 產業龍頭臻鼎科技（4958）今（27）日於國立清華大學臻鼎科技講堂舉辦「臻鼎-清華聯合研究中心第二期（2026-2030）」產學合作計畫啟動儀式，未來聚焦高階 PCB 與 IC 載板的關鍵技術和研究、智慧製造與產業價值鏈整合，以及人才培育。國立清華大學副校長邱博文表示，人才是高科技產業發展的關鍵，將繼續推動產學雙向人才交流，深化合作基礎研究與技術開發專案。

臻鼎清華大學聯合研究中心第一期五年計畫以 PCB 智慧製造與先進製程技術為核心，推動跨領域多項產學合作研發計畫與實證導入，並設立「臻鼎科技講堂」，開設「PCB 智慧製造專題」、舉辦 PCB 智慧製造證照考試，已建立產學研究共創與人才培育之平台。臻鼎科技集團總經理簡禎富也頒發論文獎金給動機系廖凡瑋同學，她參與羅丞曜教授主持之「電容壓力傳感器在機器人手指的設計、測試與仿真」計畫成果，已發表於頂尖學術期刊。

簡禎富總經理表示，未來將完善產學合作機制、強化合作研發深度，透過研發前瞻技術、AI 賦能卓越製造和戰略人才培育，促進研發成果於實際場域驗證，並加速智慧工廠之規模化導入與應用，落實數位轉型與組織發展，以配合臻鼎科技集團新一輪高速成長和全球佈局。

針對前瞻技術研發，因應 PCB 智慧感測，拓展高附加價值產品技術需求，國立清華大學化工系周鶴修教授、電機系盧向成教授及動機系羅丞曜教授共同主持之「電容、電阻壓力傳感器在機器人手指的設計、測試和仿真」計畫，將建立合作研發平台，強化臻鼎於 PCB 智慧感測領域之布局，並延伸至高附加價值應用，建立智慧機器人、穿戴裝置與人機互動等創新領域之競爭優勢。

針對卓越製造能力，國立清華大學智慧製造跨院高階主管碩士學程王宏鎔教授與國立成功大學資工系郭軒安教授共同主持之「先進規劃與智慧排程系統」，將提升產能調度彈性與即時排程效率，提升資源利用率與達交率，強化產線在面對需求波動與突發狀況時的即時應變能力，提升製造系統韌性與整體營運效率。

針對產業價值鏈整合，國立清華大學資工系賴尚宏教授主持之「AOI 異常缺陷的根因分析」計畫，則聚焦於先進品質控制與良率提升，透過強化缺陷辨識與異常預警能力，協助產線建立更即時且系統化的品質決策機制，有效降低品質成本，提升製程穩定性與產品異質整合可靠度。

臻鼎科技集團總經理簡禎富發表「PCB 產業發展機遇與臻鼎科技集團全球佈局人才發展」專題演講，並與集團品牌長李姿錡、智慧解決方案部經理黃禹傑、人力資源處副理許君萍一起和與會老師同學們交流座談，介紹 PCB 產業發展與暑期實習、產學合作和未來就業機會，師生踴躍提問熱烈交流。



▲臻鼎科技集團總經理簡禎富介紹「PCB 產業發展機遇與臻鼎科技集團全球佈局人才發展」



▲國立清華大學副校長邱博文致詞，人才是高科技產業發展的關鍵。



▲邱博文副校長、簡禎富總經理與計畫主持人周鶴修教授、盧向成教授及羅丞曜教授



▲邱博文副校長、簡禎富總經理與計畫主持人王宏鍇教授、郭軒安教授



▲邱博文副校長、簡禎富總經理與計畫主持人賴尚宏教授



▲臻鼎科技集團簡禎富總經理頒發成果論文獎金給廖凡瑋同學



▲臻鼎科技集團簡禎富總經理、李姿綺協理、黃禹傑經理、許君萍副理與師生交流座談



▲清華大學副校長邱博文（左七）、臻鼎科技集團總經理簡禎富（右六）等團隊成員出席臻鼎清華聯合研究中心產學合作計畫聯合啟動典禮

關於臻鼎科技控股

臻鼎科技控股股份有限公司(台灣證券交易所股票代號: 4958)主要從事研發、生產及銷售多樣化之軟性電路板與模組、類載板、高密度連接板、高多層及高密度印刷電路板(HLC-HDI)、多層硬板、IC 載板等產品，廣泛應用於電腦資訊、消費性電子產品、通訊網路、車用電子、AI 伺服器高速運算、光模塊與醫療等領域，提供客戶一站式購足全方位解決方案的專業服務公司。根據 Prismark 以營收計算的全球 PCB 企業排名，臻鼎 2017 年至 2025 年連續九年榮登全球最大 PCB 生產企業，更多詳細資訊請至公司網站: www.zdtco.com。

公司發言人:

凌 惇

公司治理暨投資人關係處

電話: 886 3 3830101

Email: duen.t.ling@zdtco.com